

新製品・技術トピックス

チップスタック型WABE Package®

「チップスタック型WABE Package®」は、複数のICチップを縦方向に重ね多層配線板に内蔵する技術で、電子回路のサイズを飛躍的に縮小することを可能にします。また、絶縁基材としてポリイミドフィルムを用いる事により、ICチップ2個を重ねて内蔵した場合の基板の厚さとして0.4mmの極薄化を実現しました。

本技術は、一般社団法人エレクトロニクス実装学会から技術賞に選出されるなど、高い評価を受けています。量産実績としては、電子回路の小型・薄型化が特に要求される医療分野での

採用が進んでおり、同分野での累計出荷個数は100万個を突破しました。

さらなる小型化の要求に応えるため、ICチップ3個を重ねて内蔵する構造の開発を完了しサンプル出荷を開始しました。今後も電子回路モジュールの小型・薄型化を通して、エレクトロニクス製品の新しい価値創造に貢献してまいります。

(メディカルプロダクツ営業部技術グループ
糸井和久)

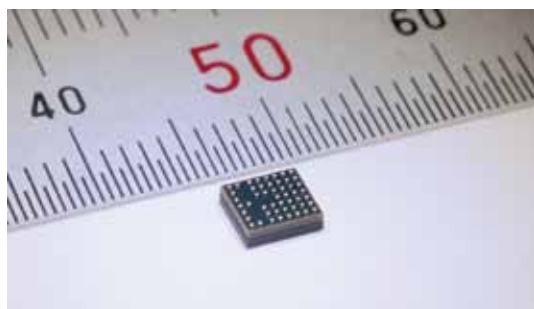


図1 チップスタック型WABE Package®を用いた部品内蔵モジュール

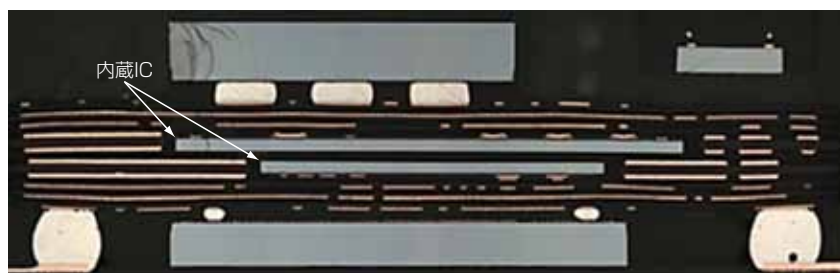


図2 チップスタック型WABE Package®の断面図

[お問い合わせ]
新規事業推進センター メディカル事業推進室
メディカルプロダクツ営業部
TEL：03-5606-1208
E-mail：medical@jp.fujikura.com